

平成 21 年 11 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社エフオーアイ  
 代表者名 代表取締役社長 奥村 裕  
 (コード番号：6253 東証マザーズ)  
 問合せ先 代表取締役専務 上畠 正和  
 (TEL. 042 - 700 - 3010 )

東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ

当社は、本日、平成 21 年 11 月 20 日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。今後とも、な  
 お一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、当社の当期の業績予想は以下のとおりであり、また、最近の決算情報等につきまして別添の  
 とおりであります。

【連結】

(単位：百万円、%)

	平成 22 年 3 月期 (予想)			平成 22 年 3 月期 第 2 四半期累計期間 (実績)		平成 21 年 3 月期 (実績)	
		構成比	前年比		構成比		構成比
売 上 高	13,013	100.0	109.8	4,893	100.0	11,855	100.0
営 業 利 益	2,774	21.3	112.1	1,067	21.8	2,474	20.9
経 常 利 益	2,197	16.9	109.0	624	12.8	2,016	17.0
当期(四半期)純利益	1,318	10.1	248.7	331	6.8	530	4.5
1 株 当 たり 当 期 ( 四 半 期 ) 純 利 益	60 円 99 銭			18 円 06 銭		32 円 33 銭	

【個別】

(単位：百万円、%)

	平成 22 年 3 月期 (予想)			平成 22 年 3 月期 第 2 四半期累計期間 (実績)		平成 21 年 3 月期 (実績)	
		構成比	前年比		構成比		構成比
売 上 高	13,013	100.0	109.8	4,893	100.0	11,855	100.0
営 業 利 益	2,764	21.2	112.1	1,064	21.8	2,466	20.8
経 常 利 益	2,187	16.8	108.8	622	12.7	2,011	17.0
当期(四半期)純利益	1,312	10.1	250.7	330	6.8	523	4.4
1 株 当 たり 当 期 ( 四 半 期 ) 純 利 益	60 円 72 銭			17 円 98 銭		31 円 93 銭	
1 株 当 たり 配 当 金	—			—		—	

(注) 1. 平成 20 年 11 月 27 日付けで株式 1 株につき 100 株の株式分割を行っております。平成 21 年 3 月期(実績)の 1 株当  
 たり当期純利益については、期首に株式分割がおこなわれたものとみなして算出しております。

2. 平成 21 年 3 月期(実績)及び平成 22 年 3 月期第 2 四半期累計期間(実績)の 1 株当たり当期(四半期)純利益は、期中平  
 均発行済株式数により算出しております。

3. 平成 22 年 3 月期(予想)の 1 株当たり当期純利益は、公募株式数 (6,750,000 株) を含めた予定期中平均発行済株式数  
 21,615,840 株(潜在株式は考慮しない)により算出し、オーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当増  
 資分は考慮しておりません。

4. 当社は、これまで利益配当を行っておりません。

以 上



平成22年3月期 第2四半期決算短信

平成 21年 11月 20日

上場会社名 株式会社エフオーアイ

上場取引所 東京証券取引所マザーズ

コード番号 6253

URL <http://www.foi.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 奥村 裕

問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役専務 (氏名) 上島 正和 TEL (042)700-3010

四半期報告書提出予定日 —

配当支払開始予定日 —

(百万円未満切捨て)

1. 平成22年3月期第2四半期の連結業績 (平成21年4月1日～平成21年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
22年3月期第2四半期	4,893	—	1,067	—	624	—	331	—
21年3月期第2四半期	—	—	—	—	—	—	—	—

	1株当たり 四半期純利益		潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益	
	円	銭	円	銭
22年3月期第2四半期	18	06	—	—
21年3月期第2四半期	—	—	—	—

(注) 当社は、平成21年3月期第2四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、21年3月期第2四半期及び22年3月期第2四半期の対前年同四半期増減率の記載をしておりません。

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%		円	銭
22年3月期第2四半期	29,176		15,801		54.1		788	94
21年3月期	29,177		13,797		47.2		810	75

(参考) 自己資本 22年3月期第2四半期 15,773百万円 21年3月期 13,768百万円

2. 配当の状況

	1株当たり配当金							
	第1四半期末		第2四半期末		第3四半期末	期末	合計	
	円	銭	円	銭	円	銭	円	銭
21年3月期	—	—	0	00	—	—	0	00
22年3月期	—	—	0	00				
22年3月期(予想)					—	—	0	00

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 : 無

3. 平成22年3月期の連結業績予想 (平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通期	13,013	109.8	2,774	112.1	2,197	109.0	1,318	248.7	60	99

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 : 無

#### 4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの)
- ① 会計基準等の改正に伴う変更 : 無
- ② ①以外の変更 : 無
- (4) 発行済株式数(普通株式)
- |                      |             |              |             |              |
|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)  | 22年3月期第2四半期 | 19,993,300 株 | 21年3月期      | 16,982,000 株 |
| ② 期末自己株式数            | 22年3月期第2四半期 | — 株          | 21年3月期      | — 株          |
| ③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) | 22年3月期第2四半期 | 18,360,662 株 | 21年3月期第2四半期 | 158,158 株    |
- ※ 平成20年11月27日付で株式1株につき100株の分割を行っております。

#### ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- 業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により予想数値が異なる可能性があります。なお、業績予想の前提となる仮定及び業績予想に関する注意事項等につきましては、5ページ「【定性的情報・財務諸表等】3. 連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。
- 平成22年3月期の連結業績予想の1株当たり当期純利益については、新規上場に伴う公募株式数(6,750,000株)を含めた予定期中平均発行済株式数21,615,840株(潜在株式は考慮しない)により算定し、オーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当増資分は考慮しておりません。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期累計期間（平成21年4月1日～平成21年9月30日）におけるわが国経済は、昨年来の世界的な金融・経済危機による景気後退には一部に回復の兆しも見え始めたものの、企業収益の縮小、設備投資の抑制、雇用情勢への不安等による個人消費の低迷は続いており、依然として不透明な状況が続いております。当社グループが参画しております半導体業界におきましては、メモリー価格の下落に歯止めがかかり、メーカーの設備稼働率も回復基調にあることから、今年度後半には一部メーカーにおいては投資が活発となるものと予測されます。

このような環境下において、当社グループは戦略的に先端微細化投資を強める顧客に対し、集中的に営業展開をいたしました。

この結果、当第2四半期（4～9月）の連結経営成績につきましては、売上高4,893百万円、営業利益は1,067百万円、経常利益は624百万円となり、四半期純利益は331百万円となりました。

なお、当第2四半期連結累計期間における業績の概況は以下のとおりです。

①売上高

売上高は4,893百万円となりました。主に、絶縁膜エッチング装置及びアッシング装置の台湾及び中国顧客の新設及び既設ライン向け販売であります。

当社グループは、東アジアを拠点として、DRAM及びNAND型フラッシュメモリー等半導体メモリーを製造している顧客を対象として販売活動を行っていることから、海外売上高は当第2四半期連結累計期間4,893百万円（海外売上高の割合100.0%）となっております。

②販売費及び一般管理費、営業利益

販売費及び一般管理費は920百万円となりました。主な内容としては、研究開発費338百万円、支払手数料280百万円であります。

研究開発活動は、市場競争力のある製品を開発すべく常に先進の技術力を保持し、顧客の生産性向上に寄与できる性能を実現できる製品及びコスト・パフォーマンスに優れた製品を提供できる開発体制の構築を目指すことを基本として、研究を日々積み重ねております。また、今後も引き続きこれらの分野におきましては、新製品の開発及び従来製品の改良を行うべく鋭意努力して参ります。研究開発費の主な内容は、自社開発製品である300mmウェハ対応の絶縁膜エッチング装置及びアッシング装置に係る研究開発であります。

この結果、営業利益は1,067百万円となりました。

③経常利益、四半期純利益

借入金に伴う利息費用及び為替変動に伴う為替差損の発生等により、経常利益は624百万円となり、法人税等実質負担額294百万円を計上した結果、四半期純利益は331百万円となりました。

## 2. 連結財政状態に関する定性的情報

### (1) 資産、負債及び純資産の増減

当第2四半期連結会計期間末における資産総額は前連結会計年度末に比べ、1百万円減少の29,176百万円となりました。主な変動要因は、借入金の返済及び未払法人税等の支払いに伴う現金及び預金の減少2,040百万円、売掛金の増加1,942百万円及び仕掛品の増加338百万円等であります。売掛金の増加は、当四半期連結累計期間の売上金額の増加に加え、売掛金回収期間が長期化する傾向にある顧客新設ライン向けの「初号機」売上分が累積することが主な要因であります。

負債総額は前連結会計年度末に比べ、2,004百万円減少の13,375百万円となりました。主な要因は短期借入金の減少946百万円及び長期借入金の減少461百万円等によるものであります。

純資産は前連結会計年度末に比べ、2,003百万円増加の15,801百万円となりました。主な要因として、第三者割当増資による資本金及び資本剰余金の増加1,671百万円及び四半期純利益331百万円の計上等によるものであります。

この結果自己資本比率は54.1%となりました。

### (2) 連結キャッシュ・フロー

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,941百万円減少の605百万円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間における四半期連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

#### (営業活動におけるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,253百万円の支出になりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益625百万円に対し、売上債権の増加1,942百万円、たな卸資産の増加338百万円、法人税等の支払額862百万円になったこと等によるものです。売上債権の増加は、当四半期連結累計期間の売上金額の増加に加え、売掛金回収期間が長期化する傾向にある顧客新設ライン向けの「初号機」売上分が累積することが主な要因であります。

#### (投資活動におけるキャッシュ・フロー)

投資活動におけるキャッシュ・フローは、99百万円の収入となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入133百万円等によるものであります。

#### (財務活動におけるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、212百万円の収入となりました。これは主に、株式発行による収入1,671百万円、短期借入金の純減少額1,036百万円、長期借入金の純減少額371百万円等があったことによるものであります。

### 3. 連結業績予想に関する定性的情報

今後の半導体市況は、世界的な景気減速・金融収縮の一定の歯止めを受け、堅調に推移すると考えております。当社グループが属する半導体製造装置市場も、半導体デバイスメーカーの設備投資気運の高まりを背景として、受注高・売上高が増加すると予測しております。当社グループの主要販売地域である東アジアの半導体デバイスメーカー各社の業績も回復基調にあり、一部に設備投資の増額が発表される等、当社グループを取り巻く環境は好転しており、引き続き受注は安定的に推移すると予測しております。よって、当第2四半期連結会計期間末時点での受注残高6,413百万円に加え、今後の受注見込みを勘案し、連結業績予想を決定しております。

なお、当社グループは、自社製品の販売を開始してからの期間が比較的短いため、数年間に分けて段階的に投資を行う顧客の半導体デバイス生産ラインの中で、安定的に投資される「新規生産ライン」向けの装置販売が多く、市況動向の影響を受けにくい傾向があります。

販売管理費につきましては、一定の人材採用を継続しており、事業規模拡大に向けた組織構築、人材育成を進めていることから増加を見込んでおりますが、同時に研究開発費等主要項目の予算管理の強化を行っており、売上高販管費率は前年対比減少を見込んでおります。

また、前連結会計年度において、当社グループの主要販売先である台湾の一部の半導体デバイスメーカーにおいて、業績悪化等に伴う資金繰り懸念が生じていたことから、当該顧客への売掛金に対して貸倒引当金579百万円を特別損失に計上しておりましたが、当連結会計年度においては、新たな引当金の計上は見込んでおりません。

以上により、平成22年3月期の通期の連結業績予想につきましては、売上高13,013百万円（前年比109.8%）、営業利益2,774百万円（前年比112.1%）、経常利益2,197百万円（前年比109.0%）、当期純利益1,318百万円（前年比248.7%）を見込んでおります。

なお、当社グループの売上高は、東アジアを拠点として、半導体デバイスメーカーを対象として販売活動を行っていることから、海外売上高は、前連結会計年度において11,851百万円（海外売上高の割合99.9%）、当第2四半期連結累計期間4,893百万円（海外売上高の割合100.0%）であり、その全てが台湾・中国等のアジア地域向けであります。そのため、海外顧客が存在する国または地域の経済的情勢等の影響により、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。足元の当該国または地域における経済状況を鑑み、当連結会計年度における連結業績予想を決定しております。

また、当社グループは一部米ドル建の販売があり、業績は為替の影響を受ける可能性があります。当連結会計年度の売上高に占める米ドル建販売比率は約15%を見込んでおりますが、1米ドル=90円前後の現在の為替水準で推移した場合には連結業績予想へ与える影響は軽微であります。

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  
該当事項はありません。
  
- (2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  
該当事項はありません。
  
- (3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更  
該当事項はありません。

5. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位:千円)

	当第2四半期 連結会計期間末 (平成21年9月30日)	前連結会計年度末に 係る要約連結貸借対照表 (平成21年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	621,611	2,661,860
売掛金	24,838,168	22,895,952
仕掛品	3,664,074	3,325,763
その他	320,441	528,852
貸倒引当金	△579,500	△579,500
流動資産合計	28,864,796	28,832,928
固定資産		
有形固定資産	187,652	220,826
無形固定資産	15,546	13,302
投資その他の資産	108,628	110,772
固定資産合計	311,827	344,900
資産合計	29,176,623	29,177,829
負債の部		
流動負債		
買掛金	535,921	599,374
短期借入金	8,670,360	9,616,730
未払法人税等	252,018	859,999
引当金	190,040	225,401
その他	1,033,622	873,341
流動負債合計	10,681,963	12,174,846
固定負債		
社債	420,000	470,000
長期借入金	2,262,730	2,724,310
その他	10,726	11,076
固定負債合計	2,693,456	3,205,386
負債合計	13,375,419	15,380,233
純資産の部		
株主資本		
資本金	6,846,674	6,009,533
資本剰余金	6,789,163	5,955,033
利益剰余金	2,153,483	1,821,839
株主資本合計	15,789,321	13,786,405
評価・換算差額等		
為替換算調整勘定	△15,865	△18,233
評価・換算差額等合計	△15,865	△18,233
新株予約権	27,747	29,423
純資産合計	15,801,203	13,797,596
負債純資産合計	29,176,623	29,177,829

(2) 四半期連結損益計算書  
(第2四半期累計期間)

(単位:千円)	
当第2四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)	
売上高	4,893,184
売上原価	2,905,376
売上総利益	1,987,807
販売費及び一般管理費	920,685
営業利益	1,067,122
営業外収益	
受取利息	1,262
還付加算金	3,451
その他	868
営業外収益合計	5,582
営業外費用	
支払利息	168,619
資金調達費用	94,772
為替差損	146,468
その他	38,098
営業外費用合計	447,959
経常利益	624,745
特別利益	
新株予約権戻入益	1,035
特別利益合計	1,035
税金等調整前四半期純利益	625,780
法人税、住民税及び事業税	231,168
法人税等調整額	62,968
法人税等合計	294,137
四半期純利益	331,643

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)	
当第2四半期連結累計期間	
(自 平成21年4月1日	
至 平成21年9月30日)	
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前四半期純利益	625,780
減価償却費	37,063
引当金の増減額 (△は減少)	△34,866
受取利息及び受取配当金	△1,262
支払利息	168,619
為替差損益 (△は益)	217
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,942,149
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△338,310
仕入債務の増減額 (△は減少)	△63,464
その他	338,723
小計	△1,209,649
利息及び配当金の受取額	783
利息の支払額	△182,466
法人税等の支払額	△862,195
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,253,528
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	△33,360
定期預金の払戻による収入	133,718
有形固定資産の取得による支出	△1,128
貸付けによる支出	△1,450
貸付金の回収による収入	1,828
その他	209
投資活動によるキャッシュ・フロー	99,816
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△1,036,000
長期借入れによる収入	80,000
長期借入金の返済による支出	△451,950
社債の償還による支出	△50,000
株式の発行による収入	1,671,271
その他	△1,080
財務活動によるキャッシュ・フロー	212,240
現金及び現金同等物に係る換算差額	124
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△1,941,346
現金及び現金同等物の期首残高	2,546,997
現金及び現金同等物の四半期末残高	605,651

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

当第2四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日）

当社及び連結子会社の事業は、半導体製造装置の開発・製造・販売及びそれに付随・関連する技術サービスを提供する半導体製造装置事業のみであり、当該事業以外に事業の種類がないため記載事項はありません。

[所在地別セグメント情報]

当第2四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日）

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90%を超えているため、記載を省略しております。

[海外売上高]

当第2四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日）

	中国	台湾	韓国	その他	計
I 海外売上高(千円)	2,564,531	2,326,425	1,697	529	4,893,184
II 連結売上高(千円)	—	—	—	—	4,893,184
III 連結売上高に占める海外売上高の割合(%)	52.4	47.6	0.0	0.0	100.0

- (注) 1 国又は地域の区分は、国別によっております。  
 2 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当社は、インベスターインベストメントエフオーアイビーヴィ他23社から平成21年6月26日、平成21年7月10日及び平成21年7月21日を期日として、第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、第2四半期連結累計期間において資本金が837,141千円、資本準備金が834,130千円増加し、当第2四半期連結会計期間末において資本金が6,846,674千円、資本剰余金が6,789,163千円となっております。

(7) 重要な後発事象

当社株式は、平成21年10月16日に株式会社東京証券取引所の承認を得て、平成21年11月20日に東京証券取引所マザーズに上場しております。当社はこの上場にあたって、平成21年10月16日及び平成21年10月30日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行及び株式売出しを決議いたしました。

1. 公募による新株式の発行（ブックビルディング方式による募集）

- |             |   |
|-------------|---|
| ① 募集株式の数    | 普通株式 6,750,000株   |
| ② 発行価格      | 1株につき 850円  |
| ③ 引受価額      | 1株につき 782円<br>引受人より当社が受取る金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額（1株につき68円）は引受人の手取金となります。 |
| ④ 発行価額      | 1株につき 680円<br>会社法上の払込金額であります。   |
| ⑤ 発行価額の総額   | 4,590,000千円   |
| ⑥ 払込金額の総額   | 5,278,500千円   |
| ⑦ 増加する資本金の額 | 1株につき 391円<br>資本組入額の総額 2,639,250千円  |
| ⑧ 払込期日      | 平成21年11月19日   |
| ⑨ 株式受渡期日    | 平成21年11月20日   |
| ⑩ 調達資金の使途   | 研究開発、借入金返済、運転資金   |

2. 引受人の当社株主からの買取引受による株式売出し

- |          |                 |
|----------|-----------------|
| ① 売出株式の数 | 普通株式 1,173,000株 |
| ② 売出価格   | 1株につき 850円      |
| ③ 株式受渡期日 | 平成21年11月20日     |

3. オーバーアロットメントによる株式売出し

- |          |                 |
|----------|-----------------|
| ① 売出株式の数 | 普通株式 1,188,400株 |
| ② 売出価格   | 1株につき 850円      |
| ③ 株式受渡期日 | 平成21年11月20日     |

4. 第三者割当増資による新株式の発行

当社では、東京証券取引所マザーズへの上場に伴い当社株主より当社普通株式を借入れたみずほインベスターズ証券株式会社が売出人となる上記3.の当社普通株式のオーバーアロットメントによる株式売出しに伴い、第三者割当増資による株式の発行の決議を行っております。その概要は次のとおりであります。

- |             |                  |
|-------------|------------------|
| ① 発行株式の数    | 普通株式 1,188,400株  |
| ② 割当価格      | 1株につき 782円       |
| ③ 払込金額      | 1株につき 680円       |
| ④ 増加する資本金の額 | 1株につき 391円       |
| ⑤ 払込期日      | 平成21年12月22日      |
| ⑥ 割当先       | みずほインベスターズ証券株式会社 |
| ⑦ 調達資金の使途   | 研究開発             |